

# Ptfe-Siliziumwafer-Halter Für Säureätzung Und Reinigungsprozess 2 4 6 8 Zoll Anpassbar Hochtemperaturbeständig

Artikelnummer: PL-CP158



## Einführung

Hochreine PTFE-Siliziumwafer-Halter, entwickelt für extreme Säureätz- und Reinigungsprozesse. Optimiert für Wafer von 2 bis 8 Zoll, gewährleisten diese robusten, anpassbaren Träger eine kontaminationsfreie Handhabung und thermische Stabilität in den anspruchsvollsten Halbleiterfertigungsumgebungen für den B2B-Einkauf.

[Mehr erfahren](#)

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
Halbleiterätzung	Handhabung von Wafern in konzentrierter HF oder BOE (Buffered Oxide Etch)-Lösungen zum Entfernen dielektrischer Schichten.	Außergewöhnliche Beständigkeit gegen aggressive Säuren gewährleistet langfristige Trägerhaltbarkeit.
RCA-Reinigungsprozesse	Einsatz von SC-1- und SC-2-Lösungen bei hohen Temperaturen zum Entfernen organischer und metallischer Verunreinigungen.	Hohe thermische Stabilität verhindert Verformung während Hochtemperatur-Oxidationsbädern.
Photovoltaikzellen-Produktion	Texturierung und Reinigung von Siliziumwafern während der Herstellung hocheffizienter Solarzellen.	Robustes Design bewältigt industriellen Hochdurchsatz mit konstanter Zuverlässigkeit.
MEMS-Fertigung	Sicheres Halten von Substraten während komplexer Deep-Reactive Ion Etching- und Nass-Release-Prozesse.	Präzisionsgefertigte Schlitze schützen empfindliche mikromechanische Strukturen vor Kontaktschäden.
Piranha-Ätzreinigung	Verarbeitung von Wafern in einer Mischung aus Schwefelsäure und Wasserstoffperoxid zum Entfernen schwerer organischer Stoffe.	Die Materialien sind immun gegen starke oxidative Angriffe und verhindern so einen Geräteabbau.
Nanotechnologie-Forschung	Spezialisierte Handhabung kundenspezifischer Substrate bei experimenteller chemischer Gasphasenabscheidung oder Flüssigphasenverarbeitung.	Vollständige Anpassbarkeit ermöglicht nicht-standardisierte Wafergrößen und Unterstützung einzigartiger Geometrien.
Optoelektronik-Montage	Reinigung von Saphir- oder GaAs-Wafern vor epitaktischem Wachstum oder Dünnschichtabscheidung.	Die Reinheit des PTFE-Materials eliminiert das Risiko von Störungen durch Spurenmetalle in optischen Bauteilen.

Spezifikationskategorie	Parameterdetails für PL-CP158	Verfügbarkeit/Optionen
Modellserie	PL-CP158 Siliziumwafer-Träger	Standard- und kundenspezifische Designs
Primärmaterial	Hochreines PTFE (Polytetrafluorethylen)	PFA-Optionen auf Anfrage verfügbar
Kompatible Wafergrößen	2 Zoll, 4 Zoll, 6 Zoll, 8 Zoll	Vollständig anpassbar an jeden Durchmesser
Schlitzkonfiguration	Kapazität und Raster werden pro Projekt definiert	Kundenspezifisch nach Benutzerspezifikation
Temperaturbereich	Einsatzfähig von kryogenen Temperaturen bis 260°C	Prozessabhängige Anpassung
Chemikalienbeständigkeit	Vollständiges Spektrum an Säuren, Basen und Lösungsmitteln	Universelle chemische Kompatibilität
Fertigungsmethode	5-Achsen-CNC-Präzisionsbearbeitung	Maßgeschneiderte Geometrie verfügbar
Ablaufmerkmale	Anpassbare Boden-/Seitenablauföffnungen	Optimiert für spezifische Bad-Durchflussraten

<b>Anwendung</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Hauptvorteil</b>
<b>Spezifikationskategorie</b>	<b>Parameterdetails für PL-CP158</b>	<b>Verfügbarkeit/Optionen</b>
<b>Griffdesign</b>	Abnehmbare oder integrierte manuelle/robotergreifbare Griffe	Angepasst für Werkzeugkompatibilität
<b>Reinheitsgrad</b>	Spurenanalyse und Halbleiterqualität	Zertifizierte hochreine Materialien